



유망산업 인사이트

유망산업 Weekly Report

2025-07-26

QYResearch Korea

Contents

섹터	유망산업 아이템
반도체	▪ GaN (Gallium Nitride) 반도체 ▪ 웨이퍼 이면 보호 필름 ▪ 웨이퍼 마운팅 장비 ▪ 에폭시 몰딩 컴파운드 ▪ 반도체 세정 코팅 : 코미코, 원익큐앤씨, 싸이노스 (보고서) ▪ 반도체 패키징 소재 : 덕산하이메탈 (보고서)
전기/전자	▪ 보드 투 보드 플로팅 커넥터 ▪ 멀티코어 광섬유 커넥터
화학/소재	▪ 특수 교정 가스 ▪ 산화 그래핀 ▪ 구상 실리카 (브리핑)
수소	▪ 중대형 수소 압축기
자동차 부품	▪ 자동차용 소형 및 중형 BLDC 모터 ▪ 자동차용 미니 Fakra 커넥터

Contents

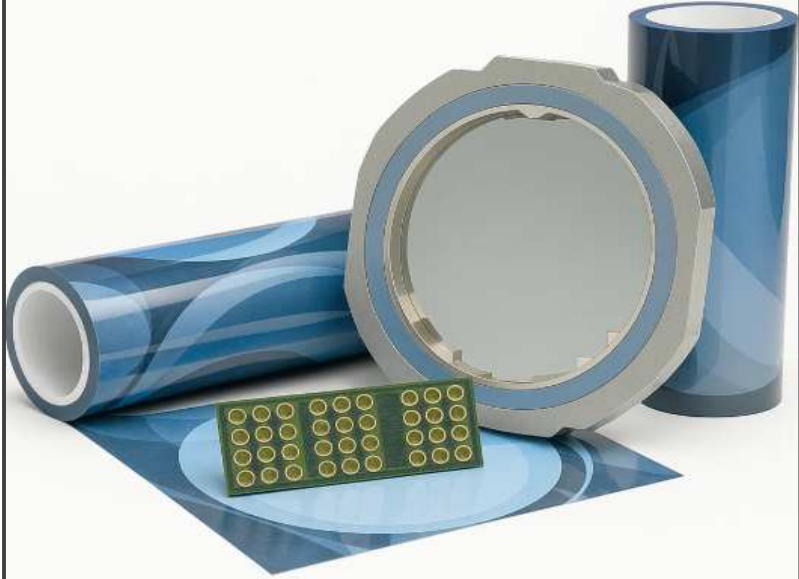


I. 반도체

GaN (Gallium Nitride) 반도체

구분	주요 내용
제품 개요	- 차세대 전력 반도체 및 고주파 디바이스용 와이드 밴드갭(Wide Band Gap) 소재로, 전력 전자 및 고주파(RF) 응용 분야 모두에서 기존보다 뚜렷한 장점을 지님 - 특히 높은 주파수에서 동작이 가능하며, 고전력 밀도를 처리할 수 있는 능력, 다양한 용도에 적용할 수 있는 유연성 보유 - 제품 유형 : Power GaN Devices, RF GaN Devices
시장 규모	2031년 76.4억 달러
CAGR	18.7%
성장 요인	현재 GaN 기반 RF 디바이스가 시장의 약 85%, GaN 전력 디바이스가 15%를 차지하고 있으나 최근 몇 년간 GaN 전력 디바이스의 성장이 빠르게 진행되고 있음
응용 분야	통신, 소비자 전자, 산업용, 자동차 및 모빌리티, 방위, 항공우주, 에너지 등
경쟁 구도	Infineon (GaN Systems), STMicroelectronics, Texas Instruments, onsemi, Microchip Technology, Rohm, NXP Semiconductors, Toshiba 등
한국 기업	알에프에이치아이씨

웨이퍼 이면 보호 필름

구분	주요 내용	
제품 개요	- 반도체 제조 공정에서 웨이퍼 뒷면 표면을 보호하는 고성능 필름 소재 - 가공 중 웨이퍼 뒷면이 기계적 스트레스, 오염, 굽힘, 화학적 부식 등으로부터 손상되는 것을 일시적으로 방지 및 보호하며, 이를 통해 칩 수율과 공정 안정성을 보장 - 제품 유형 : UV Curing Type, Non-UV Curing Type	
성장 요인	반도체 생산과 연동 (웨이퍼 연마, 절단, 이송 등의 공정에서 널리 사용)	
응용 분야	웨이퍼 절단, 에칭, 기타	
경쟁 구도	Henkel Adhesive Technologies, LINTEC, MTI ECO INNO, Mitsui Chemicals, WaferChem Technology, D&X, Jiangsu Tongli Optical New Material 등	
국내 기업	N/A (수입 의존)	

웨이퍼 마운팅 장비

구분	주요 내용	
제품 개요	- 웨이퍼를 가공하는 장비로, 자동형, 반자동형, 수동형으로 분류 - 웨이퍼 제조 공정의 일부로, 웨이퍼 연마 (그라인딩) 후 금속 프레임 위에 웨이퍼를 부착하고 필름 또는 테이프를 적용하는 과정, 절단 테이프를 웨이퍼의 뒷면이나 절단 프레임에 부착하고, 패턴닝된 웨이퍼 표면에서 보호 테이프를 제거하는 역할 수행 - 제품 유형 : Full-Automatic Wafer Mounter, Semi-Automatic Wafer Mounter, Manual Wafer Mounter	
시장 규모	2031년 18억 달러	
CAGR	5.3%	
성장 요인	필름 및 테이프를 적용함으로써 입자 오염을 줄이고, 고성능 반도체 소자나 부품의 생산을 가능하게 하는 핵심 장비	
응용 분야	300mm Wafer, 200mm and 150mm Wafer	
경쟁 구도	Nitto Denko, LINTEC, Takatori, DISCO, Teikoku Taping System, NPMT (NDS) 등	
한국 기업	쿠온솔루션	

에폭시 몰딩 컴파운드 (EMC)

구분	주요 내용	
제품 개요	- 반도체 칩과 같은 전자 부품을 외부 환경으로부터 보호하기 위해 사용되는 복합 재료 - 주요 구성 성분으로는 에폭시 수지, 경화제, 충전제(주로 실리카), 난연제 등이 포함되며, 이러한 조합을 통해 전자 부품의 열, 수분, 충격 등으로부터 보호 - 제품 유형 : Solid EMC, Liquid EMC	
시장 규모	2031년 34.4억 달러	
CARG	4.7%	
성장 요인	플립칩, 웨이퍼레벨패키징, 2.5D/3D 패키징 등 반도체 첨단 패키징용 Advanced EMC 수요 증가 (CAGR 8%)	
응용 분야	메모리, 비메모리, 개별소자, 파워모듈	
경쟁 구도	Sumitomo Bakelite, Showa Denko, Chang Chun Group, Hysol Huawei Electronics, Panasonic, Kyocera, KCC, Samsung SDI, Eternal Materials 등	
한국 기업	KCC, 삼성 SDI	

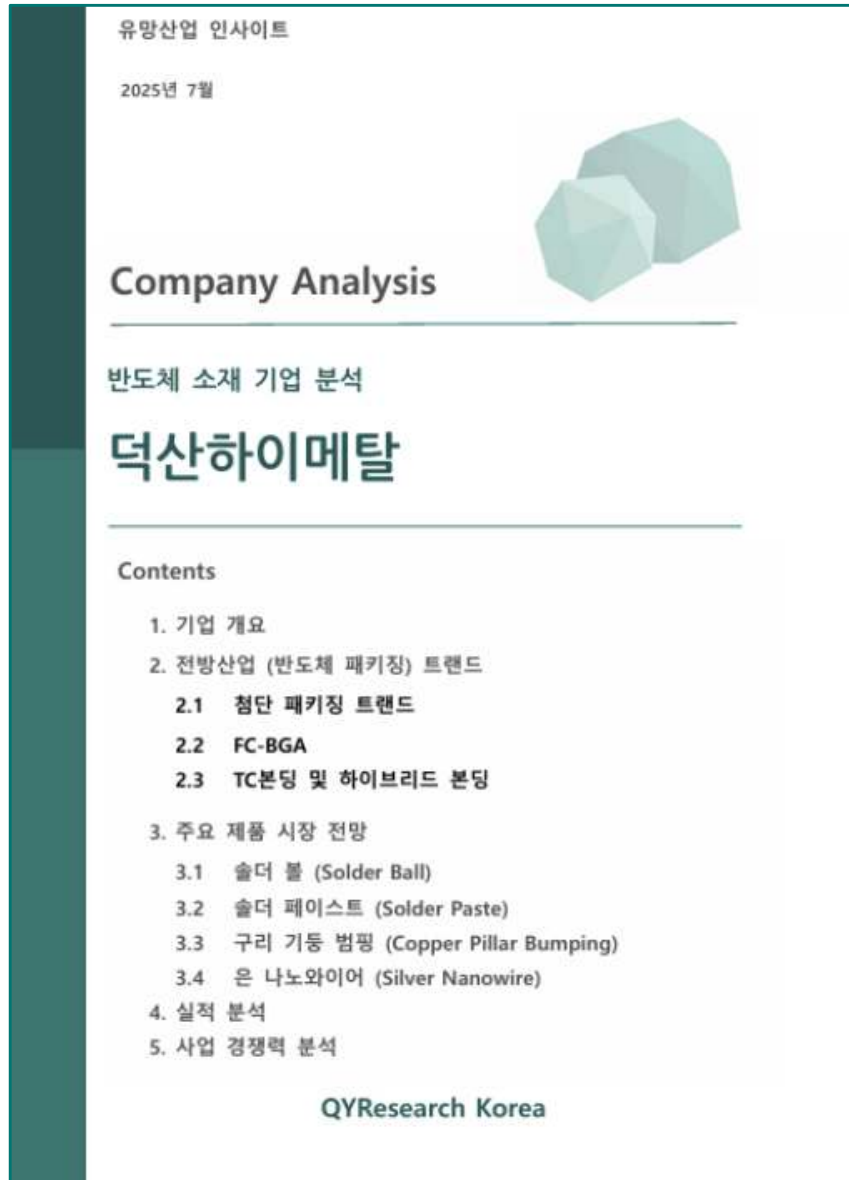
반도체 세정 및 코팅 – 코미코, 원익큐엔씨, 싸이노스



■ 목차

1. 반도체 세정 시장 개요
 - 1.1 서비스 개요
 - 1.2 글로벌 시장 전망
 - 1.3 경쟁구도 및 키플레이어
2. 반도체 코팅 시장 개요
 - 2.1 서비스 개요
 - 2.2 글로벌 시장 전망
 - 2.3 경쟁구도 및 키플레이어
3. 국내 유망기업 분석
 - 3.1 코미코
 - 3.2 원익큐엔씨
 - 3.3 싸이노스
4. 결론 및 시사점

반도체 패키징 소재 - 덕산하이메탈



■ 목차

1. 기업 개요

2. 전방산업 (반도체 패키징) 트렌드

2.1 첨단 패키징 트렌드

2.2 FC-BGA

2.3 TC본딩 및 하이브리드 본딩

3. 주요 제품 시장 전망

3.1 솔더 볼 (Solder Ball)

3.2 솔더 페이스트 (Solder Paste)

3.3 구리 기둥 범핑 (Copper Pillar Bumping)

3.4 은 나노와이어 (Silver Nanowire)

4. 실적 분석

5. 사업경쟁력 분석

Contents



II. 전기/전자

보드 투 보드 플로팅 커넥터

구분	주요 내용	
제품 개요	- PCB와 PCB 사이 전기 및 기계적 연결 부품 - 절연 재질(주로 플라스틱)로 구성된 하우징과 일정 수의 단자들로 구성되어 있으며, - 단자는 도전성이 우수한 구리 합금 등으로 제작되고 도금 처리되어 전도성과 내식성을 향상시킴	
시장 규모	2031년 19억 달러	
CAGR	9%	
성장 요인	고정밀 전자기기의 신뢰성과 내구성을 확보하는 핵심 요소로 작용하며, 고속 신호 전송 및 고집적화가 요구되는 최신 전자 시스템에서 그 중요성이 점점 더 부각되고 있음	
응용 분야	산업 설비, 자동차, 소비자 전자, 의료기기, 반도체 장비, 공장자동화	
경쟁 구도	IRISO Electronics, Hirose Electric, Amphenol, JAE, Molex, Kyocera, Samtec 등	
한국 기업	N/A	

멀티코어 광섬유 커넥터

구분	주요 내용	
제품 개요	- 멀티코어 광섬유 기반 특수 커넥터 - 기존 단일코어 광섬유와 달리 하나의 클래딩 내에 여러 코어를 포함하고 있어 높은 데이터 전송 용량, 공간 분할 다중화(SDM), 연결 구조의 복잡성 감소	
시장 규모	2031년 5.35억 달러	
CAGR	11.9%	
성장 요인	정밀한 코어 정렬, 낮은 삽입 손실, 높은 반사 손실 특성을 보장하여 고급 광통신 시스템의 핵심 요소로 평가	
응용 분야	데이터센터, 통신, 방위, 항공, 기타	
경쟁 구도	Amphenol, Molex, Sumitomo Electric, Nexans, Senko, 3M, LEMO, Hirose, T&S Communications, US Conec, Avicena, Nissin Kasei, Optical Cable Corporation	
한국 기업	N/A	

Contents



III. 화학 소재



특수 교정 가스

구분	주요 내용
제품 개요	- 차세대 제로 가스, 계기용 가스와 같은 고순도 가스, 교정 가스, 범프 테스트 가스 등의 혼합 가스를 의미 - 가스 검출 장비, 분석기 및 계측기의 교정을 위해 정밀하게 혼합된 가스로, 정확한 농도로 조제되며 국가/국제 측정 표준에 따라 인증 - 제품 유형 : Single Calibration Gases, Span Calibration Gases
시장 규모	2031년 18.7억 달러
CAGR	5.2%
성장 요인	가스 및 액체 크로마토그래피(GC, LC), 푸리에 변환 적외선 분광법(FTIR), 비분산 적외선(NDIR), 질량 분석법(MS) 등의 분석에 사용됨
응용 분야	Oil and Gas, Chemicals, Electronics, Environmental, Science and Research, Others
경쟁 구도	Linde PLC, Air Liquide, Air Products, Messer Group, Nippon Sanso, SIAD Group, Guangdong Huate Gas, Jin Hong Gas, Haohua Gas, Chemix Specialty Gases and Equipment 등
한국 기업	N/A

산화 그래핀

구분	주요 내용	
제품 개요	▪ 그래핀은 일반적으로 기계적 또는 열적 박리, 화학 기상 증착 (CVD), 에피택셜 성장법 등을 통해 생산 ▪ 크게 분말형과 분산형 두 가지가 있으며, 분산형 제품은 다양한 농도의 용액으로 제공 ▪ 농도가 낮을수록 가격이 낮아지는 경향이 있으며, 많은 제조사들이 산업용 고객에게 대량 분산액 형태로 공급	
시장 규모	▪ 2031년 5.2억 달러	
CAGR	▪ 46%	
성장 요인	▪ 산화 그래핀(Graphene Oxide, GO)의 화학적 합성 방식은 대량 생산에 있어 가장 효과적	
응용 분야	▪ 투명 전도성 필름, 바이오 제약, 합성소재, 에너지 소재	
경쟁 구도	▪ Global Graphene Group, Graphenea, Abalonyx AS, Garmor, ACS Material, Cheap Tubes, The Sixth Element Materials, BGT Materials Limited (BGT), Allightec. E WAY Technology, Jining LeaderNano Tech, Nanoinnova	
한국 기업	▪ N/A	

구상 실리카 (Spherical Silica)

	유망산업 브리핑	2025년 7월 22일 QYResearch 한국법인
---	-----------------	------------------------------------

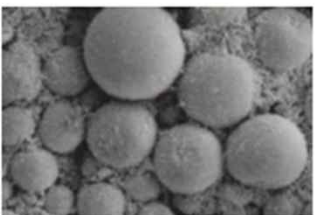
구상 실리카 (Spherical Silica) 시장 개요

- 글로벌 시장규모 연평균 6% 성장 전망
- 에폭시몰딩컴파운드(EMC), 동박적층판(CCL), 소결재, 코팅 등 넓은 응용분야
- Micron, Denka 등 미국 및 일본 기업 강세

본 자료는 QYResearch 발간, < Global Spherical Silica Market Research Report 2025>의 주요 내용을 토대로 큐와이리서치코리아 한국법인 (02-883-1278)에서 작성한 것입니다.

▶ 제품 개요

구상 실리카(Spherical Silica)는 불규칙한 모양의 실리카 분말을 플레임 융합 기법(Flame and Fusion Method), VMC 공법 등으로 가공하여 만든 구형의 실리카 분말 재료를 말합니다.



출처: 업체 자료

이 재료는 표면적이 작고 유동성이 우수하며, 낮은 용력을 특징으로 합니다. 이러한 특성 덕분에 반도체 봉지재 필러로 널리 사용되고 있습니다.

■ 목차

1. 제품 개요
2. 제품 유형 (입자 크기)
3. 응용 분야
 - (1) EMC
 - (2) CCL
 - (3) Sintering
 - (4) Coating
4. 글로벌 시장규모 전망
5. 시장 성장 및 제약 요인
6. 글로벌 경쟁 구도

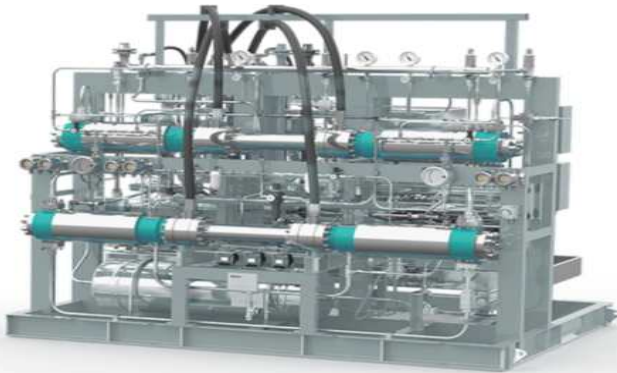
Contents



IV. 수소



중대형 수소 압축기

구분	주요 내용	
제품 개요	- 고압 및 고유량 조건에서 수소를 압축하도록 설계된 산업용 장비 - 제품 유형 : Reciprocating Hydrogen Compressors, Centrifugal Hydrogen Compressors, Diaphragm Hydrogen Compressors, Screw Hydrogen Compressors, Others	
시장 규모	2031년 34.4억 달러	
CAGR	4.7%	
성장 요인	정밀한 코어 정렬, 낮은 흡입 손실, 높은 반사 손실 특성을 보장하여 고급 광통신 시스템의 핵심 요소로 평가받고 있음	
응용 분야	Hydrogen Refueling Stations, Hydrogen Transportation, Industrial Hydrogen Production, Hydrogen Storage Systems, Others	
경쟁 구도	Burckhardt Compression, Howden, Atlas Copco, Siemens Energy, NEUMAN & ESSER, Sundyne, MAN Energy Solutions, Ariel Corporation, Baker Hughes, Hitachi Zosen, MHI Compressor, PDC Machines, HAUG Sauer Kompressoren, Hydrogenics, Linde Engineering	
한국 기업	범한퓨얼셀, 동화엔텍, 한국유수압, 한영테크노캠	

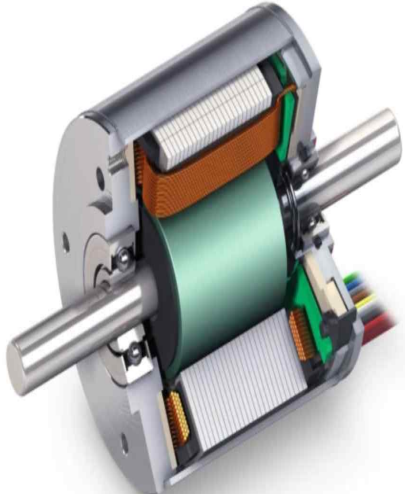
Contents



V. 자동차 부품



자동차용 소형 및 중형 BLDC 모터

구분	주요 내용	
제품 개요	12V, 24V, 48V에서 작동하며, 수 와트에서 수백 와트에 이르는 출력 범위를 가진 저전력 직류 모터로 자동차 보조 시스템 (파워 윈도우, 시트 조절, HVAC 블로워, 연료 펌프, 전자식 파킹 브레이크, 사이드미러 조절, 테일게이트 자동화 등)에 사용 - 전자식 정류 기술로 브러시 대신 홀 센서와 컨트롤러를 적용함, 최대 85~95%의 고효율, 2만 시간 이상의 수명, 저소음, 무정비 운용, ECU (전자제어장치)와의 통합성, 에너지 회수 기능 보유 - 제품 유형 : 50W 미만, 50W-200W, 201W-800W, 800W 초과	
시장 규모	2031년 85.8억 달러	
CAGR	4%	
성장 요인	전기차 등 신에너지 차량과 고급 스마트 주행 시스템, 전동 워터펌프, 전자식 터보차저, 스마트 도어락 등 고신뢰성/고효율 산업에서 전동화 시대 핵심 기술로 자리 잡고 있음	
응용 분야	승용차, 상용차	
경쟁 기업	Johnson Electric, Denso, Bosch, Brose, Mitsuba, Mabuchi Motor, Valeo, Nidec, Shenghuabo, DY, MinebeaMitsumi, Yanfeng, Leggett & Platt, Ningbo Jingcheng Motor, Marelli	
한국 기업	효성전기, 계양전기 등	

자동차용 미니 Fakra 커넥터

구분	주요 내용	
제품 개요	- 차량 내의 다양한 전자제어장치(ECU), 센서, 통신 시스템 등을 연결하기 위해 사용되는 특수한 커넥터 - 고온, 진동, 습기, 화학 물질 등 자동차 환경의 열악한 조건을 견딜 수 있도록 설계된 견고한 구조로 지님 - 제품 유형 : Waterproof Type, Non-waterproof Type	
시장 규모	2031년 129.1억 달러	
CAGR	22%	
성장 요인	차량의 전동화가 진전되면서 전기차(EV)에 탑재되는 센서와 ECU 수가 증가, ADAS 기능과 자율주행 기술 도입, 5G 네트워크 확산, 공간 절약 및 내환경성 커넥터 수요 증대	
응용 분야	자동차 (전통 연료, 전기차)	
경쟁 구도	Rosenberger, TE Connectivity, Electric Connector Technologies, Yamaichi Electronics, Amphenol, JAM, ACON, ACES, Chant Sincere, SH-Link, DOSIN	
한국 기업	N/A	

Contact

아이템별 글로벌 시장조사 보고서는 별도 주문 가능합니다.

샘플 보고서 신청 및 맞춤형 주문상담은 QYResearch Korea로 문의 바랍니다.

QYResearch Korea

큐와이리서치 코리아

서울오피스 02-883-1278 / yoona@qyresearch.com